

Fiche de procédure

Informations de base	
DEA - Procédure d'acte délégué	2013/2905(DEA)
Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur	
<p>Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à ? 20 °C</p>	
Complétant 2008/0240(COD)	
Sujet	
3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique	
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)	

Informations techniques	
Référence de procédure	2013/2905(DEA)
Type de procédure	DEA - Procédure d'acte délégué
Sous-type de procédure	Examen d'un acte délégué
Etape de la procédure	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
Dossier de la commission parlementaire	ENVI/7/14364